

# Cestello Per Pulizia Fotomask A Forma Di Fiore Con Doppia Maniglia Da 6 Pollici In Ptfе Personalizzato Resistente Alla Corrosione

Numero articolo: PL-CP05



## introduzione

I cestelli per la pulizia di fotomask da 6 pollici con doppia maniglia in PTFE personalizzato ad alte prestazioni offrono una resistenza chimica insuperabile per i processi a umido di semiconduttori e laboratori. Questi robusti cestelli a forma di fiore garantiscono una manipolazione sicura dei campioni, un drenaggio rapido e una pulizia priva di contaminanti in acidi aggressivi e solventi.

## Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
<b>Pulizia RCA Semiconduttori</b>	Immersione sequenziale di wafer di silicio in soluzioni SC-1 e SC-2 per rimuovere contaminanti organici e metallici.	La resistenza totale agli agenti ossidanti e agli acidi ad alta temperatura assicura nessun degrado del vettore.
<b>Incisione Fotomask</b>	Tenuta di fotomask da 6 pollici durante la rimozione di cromo o altri strati bloccanti della luce utilizzando incisori aggressivi.	Il posizionamento sicuro previene le vibrazioni della maschera, assicurando un trasferimento del pattern ad alta fedeltà e zero graffi superficiali.
<b>Texture Cellula Solare</b>	Processo di creazione di micro-piramidi sulle superfici di silicio utilizzando miscele di KOH o HF/HNO3 per migliorare l'assorbimento della luce.	Il design robusto a doppia maniglia consente una manipolazione sicura in ambienti industriali ad alto volume e con vasche profonde.
<b>MEMS e Microfluidica</b>	Pulizia e incisione di substrati di vetro o silicio utilizzati nella fabbricazione di Sistemi Micro-Elettro-Meccanici.	La purezza del materiale previene l'introduzione di impurità traccia che potrebbero interferire con la funzione dei dispositivi in microscala.
<b>Labware per Analisi di Tracce</b>	Tenuta di becker, coperchi o piccoli componenti durante la pulizia con vapore acido specializzata o il bagno.	L'assenza garantita di ioni metallici (senza ioni) lo rende lo standard di riferimento per l'analisi di elementi in ultra-traccia.
<b>Preparazione Vetro Conduttivo</b>	Pulizia di substrati di vetro rivestiti ITO o FTO per la ricerca su celle solari OLED o perovskite.	Il design a griglia permette un contatto fluido completo con lo strato conduttivo proteggendo i bordi del substrato.
<b>Sviluppo Chimico a Umido</b>	Trasporto di wafer rivestiti con fotoresist esposti attraverso soluzioni di sviluppo nei flussi di lavoro litografici.	La stabilità chimica attraverso vari sviluppatori organici assicura risultati costanti e zero interazione del materiale.

Parametro	Dettagli Specifiche (Modello: PL-CP05)
<b>Materiale Principale</b>	100% Polietrafluoroetilene (PTFE) Vergine ad Alta Purezza
<b>Compatibilità Substrato</b>	Fotomask, Wafer o Vetro standard da 6 pollici (152,4 mm)
<b>Configurazione Maniglia</b>	Supporto Rinforzato a Doppia Maniglia per il sollevamento verticale bilanciato
<b>Resistenza Termica</b>	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
<b>Compatibilità Chimica</b>	Universale (Tutti gli acidi, basi, solventi organici e soluzioni piranha)
<b>Configurazione Slot</b>	Larghezza slot, passo e capacità totale personalizzabili (standard 10/25 slot)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Parametro	Dettagli Specifiche (Modello: PL-CP05)	
<b>Caratteristiche Strutturali</b>	Base a griglia lavorata CNC per drenaggio rapido; punti di contatto campione arrotondati	
<b>Finitura Superficiale</b>	Superficie PTFE lavorata liscia, non porosa (Basso attrito)	
<b>Altezza Maniglia</b>	Personalizzabile per adattarsi a specifiche profondità delle vasche di pulizia	
<b>Contenuto Metallico</b>	Zero (Costruzione senza metalli)	